



Situations de contact difficiles

Étains et revêtements sans plomb

Le remplacement de l'étain contenant du plomb par l'étain sans plomb a suscité de la surprise dans l'industrie électronique. Outre le gravissime inconvénient de cette nouvelle qualité d'étain, dont le point de fusion va jusqu'à environ 10-30 K, sa forte agressivité sur des matières métalliques est remarquable. L'adaptation des paramètres de soudure aux conditions de process et de test des étains sans plomb conduit bien souvent à la dégradation des outils ou équipements de test qui en sont en contact direct.

Par ailleurs, les étains et revêtements sans plomb ont un champs d'application moins universel et entraînent souvent des problèmes techniques comme la fragilisation et la formation de whiskers. Les circuits imprimés fortement souillés ou oxydés sont une autre difficulté qui se pose dans le cadre du contact.

FEINMETALL propose une très grande variété de pointes de test spécialement développées pour faire face à ces difficultés mentionnées ci-dessus et avec lesquelles nos clients testent avec succès depuis plusieurs décennies.

